

処理技術保有企業に対するヒアリング事項

東京事業部会において、平成 14 年 10 月に実施した PCB 処理技術保有企業に対するヒアリングの項目及びその主な内容は次のとおり。

ヒアリング項目	ヒアリング内容
1. 全体処理システム	
(1) 処理技術の組合せ	・ 各社提案のトランス・コンデンサ処理と安定器処理に關しての処理技術の組合せ
(2) ブロックフロー	・ トランス・コンデンサ処理に安定器処理を組合せた各社提案処理システムのブロックフロー
(3) マテリアルバランス	・ 各社提案処理システムのマテリアルバランス
(4) 配置計画	・ 各社提案処理システムの各工程の設備構成が分かるようなレイアウト図 ・ それぞれの設備に必要なスペース
(5) 運転タイムチャート	・ 各社提案処理システムの運転タイムチャート ・ トランス・コンデンサ処理と安定器処理の組合せ ・ 前処理工程及び液処理工程の処理対象物毎の所要処理時間
2. トランス・コンデンサ処理と安定器処理の組合せによる特徴	
(1) 主要工程の設備構成	・ トランス・コンデンサ処理の工程、安定器処理の工程及び共有する工程別の主要機器ならびに系列数
(2) 組合せによる効率化	・ トランス・コンデンサ処理と安定器処理の組合せによる効率化の具体的内容
(3) 共有工程の留意点	・ 共有工程に關する設計及び運転管理上の留意点
(4) 共有工程に關して実証すべき課題と取組み状況	・ 共有工程に關して、今後の予定も含めて実証すべき課題とそれらの課題に対する取組み状況
(5) その他の処理対象物に關する設計及び運転管理上の留意点	・ その他の処理対象物（低容量低圧トランス・コンデンサ、その他機器、廃 PCB）に關する設計及び運転管理上の留意点
3. 安定器処理に係る最新の実績 3-1. 安定器処理に対する取組み	
(1) 処理の考え方（特徴）	・ 各社提案処理システムの処理の考え方（特徴）
(2) 概略処理フロー	・ 各社提案処理システムの概略処理フロー
(3) これまでの取組み（関連技術開発状況）	・ これまでに実施した実証試験等の実績、設計用データの取得の状況
(4) 今後の取組み（実証試験等の計画）	・ 実証試験等の具体的な内容及びスケジュールを含めた今後の取組み予定

3 - 2 . 安定器処理に関する実証試験等の実績	
・ 処理台数	・ これまで処理した安定器の台数（安定器の種類、PCB含有の有無、サイズの違い）
・ 安定器の解体・コンデンサの取出し実績	・ 安定器の解体、コンデンサの取出し実績の有無と、それをどのように行ったか、機械化の程度等
・ コンデンサの解体または破砕実績	・ コンデンサの解体または破砕の実績の有無、解体または破砕をどのように行ったか、機械化の程度
・ コンデンサ解体物等のPCB除染処理実績	・ コンデンサ解体物等のPCB除染処理実績（非含浸物と含浸物で処理方法が異なる場合には、分別の方法とそれぞれの処理方法）
・ 安定器ケース、充填材等の処理実績	・ コンデンサを除く安定器ケース、充填材等の処理実績の有無及び処理方法（金属類と樹脂類で処理方法が異なる場合には、分別の方法とそれぞれの処理方法）
・ 安定器一括処理実績	・ 安定器一括処理実績の有無及び処理方法
・ 卒業判定の実績	・ 非含浸物、含浸物それぞれについて卒業判定の実績の有無及び判定方法・基準・判定結果
・ 液処理の実績	・ 安定器から回収した洗浄液、真空加熱分離液等の処理実績の有無及び処理方法
3 - 3 . 安定器処理方法について	
(1) 安定器内部の汚染について	・ 安定器内部の汚染の有無及びその判定方法 ・ 内部汚染が生じている安定器の処理方法
(2) 安定器の分別及び処理について	・ 充填材の種類（アスファルト、樹脂等）に応じた分別及び処理の必要性 ・ 必要な場合の充填材の分別及び処理方法
(3) 解体作業の自動化等について	・ 安定器の解体・コンデンサの取出し作業について、安全かつ効率的な解体・取出し方法と処理ラインの構成、合理的な自動化（機械化）の範囲 ・ 作業従事者の安全確保及び負担軽減方策
(4) 加熱処理について	・ 加熱により揮発する可能性のある物質についての安全確認
(5) 洗浄処理について	・ 樹脂等の部材の種類及び性状に応じた最適な洗浄溶剤、洗浄方法、選別方法
(6) 卒業判定について	・ 処理方法に応じた容易かつ確実な卒業判定方法（特に安定器ケース及び充填物等の汚染物の卒業判定方法）
(7) 液処理について	・ 洗浄液あるいは真空加熱分離液に含まれる可能性のある混入物に対する液処理の適応性 ・ ナトリウム、アルカリ等の薬剤消費量の低減策